

第90回半導体・集積回路技術シンポジウム

開催日： 2026年8月25日（火）、26日（水）

ハイブリッド開催

現地会場：東京エレクトロン 赤坂本社

（〒107-6338 東京都港区赤坂5-3-1）

主催：電気化学会電子材料委員会

共催：ECS(米国電気化学会)日本支部

協賛：応用物理学会，エレクトロニクス実装学会，精密工学会，電子情報通信学会，
日本表面真空学会，日本化学会

プログラム

◇ 第1日 ◇ 8月25日(火) 9:50~18:30

司会 清水 智弘 (関西大学)

<9:50-10:00>

開会の挨拶

山梨大学 近藤 英一

座長 百瀬 健 (熊本大学)

<10:00-10:40>

1. 半導体製造用ナノインプリント技術の最新動向

キヤノン (株) 伊藤 俊樹

<10:40-11:20>

2. AI時代の半導体パッケージ技術: 巨大化と微細化を支えるマスクレス露光装置の重要性

(株) SCREEN セミコンダクターソリューションズ 長尾 竜也

<11:20-12:00>

3. 機械学習ポテンシャルと COSMO-SAC 熱力学モデルを用いた原子層プロセスの解析と設計

東京大学/北海道大学 霜垣 幸浩

<12:00-12:10> 午前の発表についての全体質疑

<12:10-13:40> 昼食

座長 渡邊 桂 (KIOXIA)

<13:40-14:20>

4. Development of 300mm Wafer-Scale Processing of Graphene and Related 2D Material

東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ (株) 松本 貴士

<14:20-15:00>

5. ラジカルプロセスによる金属反応層に関する研究

関西大学 大堀 大介

<15:00-15:40>

6. 高いチャネル移動度と E-mode 動作を実現する GaN パワーデバイスの MOS チャネル制御

(株) 豊田中央研究所 成田 哲生

<15:40-15:50> 午後前半の発表についての全体質疑

<15:50-16:00> 休憩

座長 上野 和良 (横浜国立大学)

<16:00-16:40>

7. AI時代の半導体市場の読み方

株式会社 SBI 証券 和田木 哲哉

<16:40-17:20>

8. 北の大知〜力の限り半導体〜

北海道大学 秋永 広幸

<17:20-17:30> 午後後半の発表についての全体質疑
<17:30-17:40> 休憩

座長 清水 智弘 (関西大学)

<17:40-18:30> 一般講演セッション (ポスター)

<18:30-19:30> 情報交換会

◇ 第2日 ◇ 8月26日(水) 9:30~17:50

座長 彦坂 幸信 (RAMXEED)

<9:30-10:10>

9. ダイヤモンド半導体デバイス研究開発の最近の進展

佐賀大学ダイヤモンド半導体研究センター/ (株) ダイヤモンドセミコンダクター 嘉数 誠

<10:10-10:50>

10. 3次元フラッシュメモリ製造における低温高アスペクト比エッチングの課題と展望

キオクシア (株) 大村 光広

<10:50-11:30>

11. Material and Process Innovation in CoWoS® Technology as a Key Enabler for Continuous Evolution of AI/HPC

TSMC ジャパン 3DIC 研究開発センター (株) 山口 晋平

<11:30-11:40> 午前の発表についての全体質疑

<11:40-13:10> 昼食

座長 三谷 祐一郎 (東京都市大学)

<13:10-13:50>

12. Flash Memory for Generative AI

キオクシア (株) 先端技術研究所 住吉 一成

<13:50-14:30>

13. メモリ高性能化・微細化へのプロセスソリューション

東京エレクトロン (株) 大池 昇

<14:30-15:10>

14. 新規不揮発性メモリの課題と今後の展望

キオクシア (株) 先端技術研究所 吉川 将寿

<15:10-15:20> 午後前半の発表についての全体質疑

<15:20-15:30> 休憩

座長 近藤 敏彰 (愛知工科大学)

<15:30-16:10>

15. ハフニア系強誘電体の薄膜化による低動作電圧化とメモリ信頼性の課題

東京大学 トープラサートボン・カシディット

<16:10-16:50>

16. 次世代脳型 AI ハードウェアに向けて

帝京大学 堀尾 喜彦

<16:50-17:30>

17. Cu-Cu 接合技術を用いた CMOS イメージセンサの進化と展望

ソニーセミコンダクタソリューションズ (株) 小川 直樹

<17:30-17:40> 午後後半の発表についての全体質疑

<17:40-17:50> 優秀発表賞 贈呈、閉会の挨拶

第89回半導体・集積回路技術シンポジウム プログラム委員会

電子材料委員会委員長	近藤 英一	山梨大学
プログラム委員会委員長	清水 智弘	関西大学
プログラム委員会委員	伊藤 理	ヌヴォトンテクノロジージャパン
	上野 和良	横浜国立大学
	木野 久志	九州大学
	鈴木 健太	産業総合技術研究所
	早瀬 仁則	東京理科大学
	彦坂 幸信	RAMXEED
	前川 和義	ルネサスエレクトロニクス
	三谷 祐一郎	東京都市大学

電気化学会 電子材料委員会

委員長	近藤 英一	山梨大学
副委員長	早瀬 仁則	東京理科大学
幹事	百瀬 健	熊本大学
委員	伊藤 理	ヌヴォトンテクノロジージャパン
	井上 史大	横浜国立大学
	落水 洋聡	ソシオネクスト
	北野 尚武	Rapidus
	木野 久志	九州大学
	小林 清輝	電子科学株式会社
	近藤 敏彰	愛知工科大学
	齊藤 丈靖	大阪公立大学
	清水 智弘	関西大学
	鈴木 健太	産業総合技術研究所
	竹下 優	東京応化工業
	筒井 一生	東京科学大学
	彦坂 幸信	RAMXEED
	藤方 淳平	荏原製作所
	前川 和義	ルネサスエレクトロニクス
	松川 和人	SUMCO
	三谷 祐一郎	東京都市大学
	森 義弘	スクリーンセミコンダクターソリューションズ
	森本 保	東京エレクトロン
	八重 真治	兵庫県立大学
	柳 至	東京大学
	渡邊 桂	KIOXIA
顧問	上野 和良	芝浦工業大学
	新宮原 正三	関西大学